

Kontaktdaten

Firma

Ansprechpartner

Anschrift

Abteilung

Telefon

E-Mail

Produkt | Baugruppe

Beschreibung

Liefermenge

Artikel-Nr.

Liefertermin

Materialbeschaffung | Materialbeistellung

Durch uns ja nein

Material 100% Beistellung ja nein

siehe Stückliste ja nein

Leiterplatte wird beigestellt ja nein

Bitte PDF Leiterplattenspezifikation anfordern

Entwicklung

Hardware ja nein

Software ja nein

Fertigung von

a.) einer Baugruppe ja nein

b.) einem Kompletgerät ja nein
(Baugruppe plus Gehäuse)**Fragen zur Leiterplatte**

Anzahl der Lagen

Anzahl der Leiterplatten im Nutzen

Abmessungen der Einzelplatine L x B x H in mm

gefräste Konturen

Bestückungsdruck

Bestückungstechnologie					
Bestückung	ja	nein	einseitig	zweiseitig	
SMD Bestückung	ja	nein	einseitig	zweiseitig	
THT Bestückung	ja	nein	einseitig	zweiseitig	
Bestückungsdruck	ja	nein	einseitig	zweiseitig	

Löten von THT Bauteilen (Mehrfachnennungen möglich)					
selektivgelötet	ja	nein			
wellengelötet	ja	nein			
handgelötet	ja	nein			

Prüfung					
Optische Prüfung mit „Quins“	ja	nein			
AOI	ja	nein			
Elektrische Prüfung	ja	nein			
BGA-Inspektion	ja	nein			

Prüfung					
Zukaufteil (Beistellung)	ja	nein			
Fertigung durch Baudisch	ja	nein			
Abmessungen L x B x H in mm		x		x	
Material	AL	pulverbeschichtet	RAL-Farbe		
	V2A				
	V4A				

Datenbereitstellung					
Stückliste	Bestückungsplan		Schablonendaten		
Gerberdaten der LP	Zeichnungen		Fotos		
Koordinatenliste					

Bemerkungen					

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung

Vertrieb	Tel. +49 71 72 926 13-0
Entwicklung	Tel. +49 71 72 926 13-52

Bitte senden Sie Ihre Anfrage an:
vertrieb@baudisch.de